

2023-2029年中国半导体晶 圆搬运设备市场深度研究与投资前景报告

报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制

www.chinairr.org

一、报告报价

《2023-2029年中国半导体晶圆搬运设备市场深度研究与投资前景报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0601/202308/25-552116.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: sales@chyxx.com

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

产业研究报告网发布的《2023-2029年中国半导体晶圆搬运设备市场深度研究与投资前景报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

第1章：半导体晶圆搬运设备行业综述及数据来源说明

1.1 半导体设备行业界定

1.1.1 芯片制程工艺流程及设备需求

1.1.2 半导体设备类型

1.1.3 《国民经济行业分类与代码》中半导体设备行业归属

1.2 半导体晶圆搬运设备行业界定

1.2.1 半导体晶圆搬运设备的重要性

1.2.2 半导体自动物料搬运系统（AMHS）

1.2.3 半导体晶圆搬运设备专业术语

1.3 本报告研究范围界定说明

1.4 半导体晶圆搬运设备行业监管规范体系

1.4.1 半导体晶圆搬运设备行业监管体系介绍

1、中国半导体晶圆搬运设备行业主管部门

2、中国半导体晶圆搬运设备行业自律组织

1.4.2 半导体晶圆搬运设备制造企业应取得《特种设备制造许可证》

1.4.3 半导体晶圆搬运设备行业标准体系建设现状（国家/地方/行业/团体/企业标准）

1、中国半导体晶圆搬运设备标准体系建设

2、中国半导体晶圆搬运设备现行标准汇总

3、中国半导体晶圆搬运设备即将实施标准

4、中国半导体晶圆搬运设备重点标准解读

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

1.5.1 本报告权威数据来源

1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明

第2章：全球半导体晶圆搬运设备行业发展现状及市场趋势洞察

2.1 全球半导体晶圆搬运设备行业发展历程介绍

2.2 全球半导体晶圆搬运设备行业技术发展现状

2.3 全球半导体晶圆搬运设备行业发展现状分析

2.3.1 全球半导体晶圆搬运设备行业兼并重组状况

2.3.2 全球半导体晶圆搬运设备行业市场竞争格局

2.3.3 全球半导体晶圆搬运设备行业市场供需状况

2.3.4 全球半导体晶圆搬运设备行业市场贸易状况

2.3.5 全球半导体晶圆搬运设备行业细分市场分析

2.4 全球半导体晶圆搬运设备行业市场规模体量及趋势前景预判

2.4.1 全球半导体设备行业市场规模体量

2.4.2 全球半导体晶圆搬运设备行业市场规模体量

1、晶圆厂设备市场规模

2、半导体晶圆搬运市场规模

2.4.3 全球半导体晶圆搬运设备行业市场前景预测（未来5年数据预测）

2.4.4 全球半导体晶圆搬运设备行业发展趋势预判（疫情影响等）

2.5 全球半导体晶圆搬运设备行业区域发展格局及重点区域市场研究

2.5.1 全球半导体晶圆搬运设备行业区域发展格局

1、半导体设备区域竞争格局

2、晶圆厂设备区域竞争格局

2.5.2 全球半导体晶圆搬运设备行业重点区域市场发展状况

1、美国半导体晶圆搬运设备行业发展状况分析

（1）美国半导体行业发展情况

（2）美国半导体设备发展情况

2、日本半导体晶圆搬运设备行业发展状况分析

（1）日本半导体行业发展情况

（2）日本半导体设备行业发展情况

2.6 全球半导体晶圆搬运设备行业发展经验借鉴

第3章：中国半导体晶圆搬运设备行业发展现状及市场痛点解析

3.1 中国半导体晶圆搬运设备行业技术发展现状

3.1.1 半导体行业技术迭代历程

- 3.1.2 半导体晶圆搬运设备效率影响因素分析
- 3.1.3 半导体晶圆搬运设备行业科研投入水平（研发力度&强度）
- 3.1.4 中国半导体晶圆搬运设备行业科研和创新状况
 - 1、悬挂式晶圆盒搬运设备定位方法与流程
 - 2、晶圆盒搬运机器人的制作方法
- 3.1.5 中国半导体晶圆搬运设备行业专利申请及公开情况
- 3.1.6 半导体晶圆搬运设备行业最新技术动态
- 3.2 中国半导体晶圆搬运设备行业发展历程介绍
- 3.3 中国半导体晶圆搬运设备行业对外贸易状况
 - 3.3.1 中国半导体晶圆搬运设备行业进出口贸易概况
 - 1、中国半导体晶圆搬运设备行业进出口总额
 - 2、中国半导体晶圆搬运设备行业贸易逆差
 - 3.3.2 中国半导体晶圆搬运设备行业进口贸易状况
 - 1、半导体晶圆搬运设备行业进口贸易额规模
 - 2、半导体晶圆搬运设备行业进口贸易数量规模
 - 3、半导体晶圆搬运设备行业进口价格水平
 - 4、半导体晶圆搬运设备行业进口来源地
 - 3.3.3 中国半导体晶圆搬运设备行业出口贸易状况
 - 1、半导体晶圆搬运设备行业出口贸易额规模
 - 2、半导体晶圆搬运设备行业出口贸易数量规模
 - 3、半导体晶圆搬运设备行业出口价格水平
 - 4、半导体晶圆搬运设备行业出口来源地
 - 3.3.4 中国半导体晶圆搬运设备行业进出口贸易影响因素及发展趋势
 - 1、中国半导体晶圆搬运设备行业进出口贸易影响因素
 - 2、中国半导体晶圆搬运设备行业进出口贸易发展趋势
- 3.4 中国半导体晶圆搬运设备行业市场主体分析
 - 3.4.1 中国半导体晶圆搬运设备行业市场主体类型（投资/经营/服务/中介主体）
 - 3.4.2 中国半导体晶圆搬运设备行业企业入场方式（自建/并购/战略合作等）
 - 3.4.3 中国半导体晶圆搬运设备行业企业数量规模
 - 3.4.4 中国半导体晶圆搬运设备行业注册企业特征
- 3.5 中国半导体晶圆搬运设备行业招投标市场解读
 - 3.5.1 中国半导体晶圆搬运设备行业招投标信息汇总

- 3.5.2 中国半导体晶圆搬运设备行业招投标信息解读
- 3.6 中国半导体晶圆搬运设备行业市场供需状况
 - 3.6.1 中国半导体晶圆搬运设备行业市场供给状况
 - 3.6.2 中国半导体晶圆搬运设备行业市场需求分布
- 3.7 中国半导体晶圆搬运设备行业市场规模体量
 - 3.7.1 中国半导体晶圆搬运设备行业市场规模测算逻辑
 - 3.7.2 中国半导体晶圆搬运设备行业市场规模
- 3.8 中国半导体晶圆搬运设备行业市场发展痛点

第4章：中国半导体晶圆搬运设备行业市场竞争状况及融资并购

- 4.1 中国半导体晶圆搬运设备行业市场竞争布局状况
 - 4.1.1 中国半导体晶圆搬运设备行业竞争者入场进程
 - 4.1.2 中国半导体晶圆搬运设备行业竞争者省市分布热力图
 - 4.1.3 中国半导体晶圆搬运设备行业竞争者战略布局状况
- 4.2 中国半导体晶圆搬运设备行业市场竞争格局分析
 - 4.2.1 中国半导体晶圆搬运设备行业企业竞争集群分布
 - 4.2.2 中国半导体晶圆搬运设备行业企业竞争格局分析
 - 4.2.3 中国半导体晶圆搬运设备行业市场集中度分析
- 4.3 中国半导体晶圆搬运设备行业国产替代布局与发展现状
 - 4.3.1 中国半导体晶圆搬运设备企业国际市场竞争参与状况
 - 4.3.2 中国半导体晶圆搬运设备行业国产替代布局状况
- 4.4 中国半导体晶圆搬运设备行业波特五力模型分析
 - 4.4.1 中国半导体晶圆搬运设备行业供应商的议价能力
 - 4.4.2 中国半导体晶圆搬运设备行业消费者的议价能力
 - 4.4.3 中国半导体晶圆搬运设备行业新进入者威胁
 - 4.4.4 中国半导体晶圆搬运设备行业替代品威胁
 - 4.4.5 中国半导体晶圆搬运设备行业现有企业竞争
 - 4.4.6 中国半导体晶圆搬运设备行业竞争状态总结
- 4.5 中国半导体晶圆搬运设备行业投融资、兼并与重组状况
 - 4.5.1 中国半导体晶圆搬运设备行业投融资发展状况
 - 4.5.2 中国半导体晶圆搬运设备行业兼并与重组状况

第5章：中国半导体晶圆搬运设备产业链全景梳理及配套产业

5.1 中国半导体晶圆搬运设备产业链结构梳理

5.2 中国半导体晶圆搬运设备产业链生态图谱

5.3 中国半导体晶圆搬运设备产业链区域热力图

5.4 中国半导体晶圆搬运设备行业成本结构分析

5.5 中国半导体晶圆搬运设备零部件/组件市场分析

5.5.1 半导体晶圆搬运设备零部件/组件概述

5.5.2 半导体晶圆搬运设备零部件/组件市场发展现状

1、半导体晶圆搬运设备硬件存储单元概况

2、半导体晶圆搬运设备硬件搬送单元概况

5.5.3 半导体晶圆搬运设备零部件/组件供给分析

1、搬运单元供给能力分析

2、存储单元供给能力分析

5.6 中国半导体晶圆搬运设备软件控制系统分析

5.6.1 半导体晶圆搬运设备软件控制系统概述

1、半导体晶圆搬运设备软件控制单元概况

2、半导体晶圆搬运设备控制单元特点

5.6.2 半导体晶圆搬运设备软件控制系统市场分析

5.6.3 半导体晶圆搬运设备软件控制系统趋势前景

5.7 中国半导体晶圆搬运设备检测与维修市场分析

5.7.1 半导体晶圆搬运设备检测与维修概述

5.7.2 半导体晶圆搬运设备检测与维修市场发展现状

5.7.3 半导体晶圆搬运设备检测与维修市场趋势前景

5.8 配套产业布局对半导体晶圆搬运设备行业发展的影响总结

第6章：中国半导体晶圆搬运设备行业中游市场发展状况

6.1 中国半导体晶圆搬运设备本体制造市场分析

6.2 中国半导体晶圆搬运设备系统集成市场分析

6.3 中国半导体晶圆搬运机器人市场分析

6.3.1 晶圆搬运机器人概述

6.3.2 晶圆搬运机器人市场发展现状

1、晶圆搬运机器人市场规模

2、晶圆搬运机器人竞争格局

6.3.3 晶圆搬运机器人发展趋势前景

6.4 中国半导体自动物料搬运系统（AMHS）市场分析

6.4.1 半导体自动物料搬运系统（AMHS）概述

6.4.2 半导体自动物料搬运系统（AMHS）市场发展现状

6.4.3 半导体自动物料搬运系统（AMHS）发展趋势前景

第7章：中国半导体晶圆搬运设备行业下游应用市场分析

7.1 中国半导体晶圆搬运设备行业下游应用场景/行业领域分布

7.1.1 中国半导体晶圆搬运设备应用场景分布

7.1.2 中国半导体晶圆搬运设备应用领域分布

1、半导体晶圆搬运设备应用行业领域分布

2、半导体晶圆搬运设备应用市场渗透概况.

7.2 中国集成电路领域半导体晶圆搬运设备需求潜力分析

7.2.1 中国集成电路市场分析

1、集成电路发展现状

2、集成电路趋势前景

7.2.2 集成电路领域半导体晶圆搬运设备需求概述（特征/产品等）

7.2.3 中国集成电路领域半导体晶圆搬运设备需求现状分析

7.2.4 中国集成电路领域半导体晶圆搬运设备需求趋势前景

7.3 中国传感器领域半导体晶圆搬运设备需求潜力分析

7.3.1 中国传感器市场分析

1、传感器发展现状

2、传感器趋势前景

7.3.2 传感器领域半导体晶圆搬运设备需求概述（特征/产品等）

7.3.3 中国传感器领域半导体晶圆搬运设备需求现状分析

7.3.4 中国传感器领域半导体晶圆搬运设备需求趋势前景

7.4 中国分立器件领域半导体晶圆搬运设备需求潜力分析

7.4.1 中国分立器件市场分析

1、分立器件发展现状

2、分立器件趋势前景

7.4.2 分立器件领域半导体晶圆搬运设备需求概述（特征/产品等）

- 7.4.3 中国分立器件领域半导体晶圆搬运设备需求现状分析
- 7.4.4 中国分立器件领域半导体晶圆搬运设备需求趋势前景
- 7.5 中国光电器件领域半导体晶圆搬运设备需求潜力分析
 - 7.5.1 中国光电器件市场分析
 - 1、光电器件发展现状
 - 2、光电器件趋势前景
 - 7.5.2 光电器件领域半导体晶圆搬运设备需求概述（特征/产品等）
 - 7.5.3 中国光电器件领域半导体晶圆搬运设备需求现状分析
 - 7.5.4 中国光电器件领域半导体晶圆搬运设备需求趋势前景
- 7.6 中国半导体晶圆搬运设备行业细分应用市场战略地位分析

第8章：全球及中国半导体晶圆搬运设备企业案例研究

- 8.1 全球及中国半导体晶圆搬运设备企业布局梳理与对比
- 8.2 全球半导体晶圆搬运设备企业布局分析（不分先后，可定制）
 - 8.2.1 美国布鲁克斯自动化（Brooks）
 - 1、企业发展历程及基本信息
 - 2、企业运营状况
 - 3、企业半导体晶圆搬运设备业务布局状况
 - 4、企业半导体晶圆搬运设备业务销售网络布局
 - 5、企业半导体晶圆搬运设备业务市场地位及在华布局
 - 8.2.2 日本Rorze
 - 1、企业发展历程及基本信息
 - 2、企业运营状况
 - 3、企业半导体晶圆搬运设备业务布局状况
 - 4、企业半导体晶圆搬运设备业务销售网络布局
 - 5、企业半导体晶圆搬运设备业务市场地位及在华布局
 - 8.2.3 日本DISCO
 - 1、企业发展历程及基本信息
 - 2、企业运营状况
 - 3、企业半导体晶圆搬运设备业务布局状况
 - 4、企业半导体晶圆搬运设备业务销售网络布局
 - 5、企业半导体晶圆搬运设备业务市场地位及在华布局

8.2.4 日本电产三协株式会社

- 1、企业发展简介
- 2、企业运营状况
- 3、企业半导体晶圆搬运设备业务布局状况
- 4、企业半导体晶圆搬运设备业务销售网络布局
- 5、企业半导体晶圆搬运设备业务市场地位及在华布局

8.3 中国半导体晶圆搬运设备企业布局分析（不分先后，可定制）

8.3.1 上海大族富创得科技有限公司

- 1、企业发展历程及基本信息
- 2、企业业务架构及经营情况
- 3、企业半导体晶圆搬运设备业务布局及发展状况
 - （1）企业半导体晶圆搬运设备产品类型/型号/品牌
 - （2）企业半导体晶圆搬运设备业务生产端布局状况
 - （3）企业半导体晶圆搬运设备业务销售及应用领域
- 4、企业半导体晶圆搬运设备业务最新发展动向追踪
- 5、企业半导体晶圆搬运设备业务发展优劣势分析

8.3.2 菲科半导体（张家港）有限公司

- 1、企业发展历程及基本信息
- 2、企业业务架构及经营情况
- 3、企业半导体晶圆搬运设备业务布局及发展状况
 - （1）企业半导体晶圆搬运设备产品类型/型号/品牌
 - （2）企业半导体晶圆搬运设备业务生产端布局状况
 - （3）企业半导体晶圆搬运设备业务销售及应用领域
- 4、企业半导体晶圆搬运设备业务最新发展动向追踪
- 5、企业半导体晶圆搬运设备业务发展优劣势分析

8.3.3 上海果纳半导体技术有限公司

- 1、企业发展历程及基本信息
- 2、企业业务架构及经营情况
- 3、企业半导体晶圆搬运设备业务布局及发展状况
 - （1）企业半导体晶圆搬运设备产品类型/型号/品牌
 - （2）企业半导体晶圆搬运设备业务生产端布局状况
 - （3）企业半导体晶圆搬运设备业务销售及应用领域

- 4、企业半导体晶圆搬运设备业务最新发展动向追踪
- 5、企业半导体晶圆搬运设备业务发展优劣势分析

8.3.4 舜宇光学科技（集团）有限公司

- 1、企业发展历程及基本信息
- 2、企业业务架构及经营情况
- 3、企业半导体晶圆搬运设备业务布局及发展状况
 - (1) 企业半导体晶圆搬运设备产品类型/型号/品牌
 - (2) 企业半导体晶圆搬运设备业务生产端布局状况
 - (3) 企业半导体晶圆搬运设备业务销售及应用领域
- 4、企业半导体晶圆搬运设备业务最新发展动向追踪
- 5、企业半导体晶圆搬运设备业务发展优劣势分析

8.3.5 昀智科技（北京）有限责任公司

- 1、企业发展历程及基本信息
- 2、企业业务架构及经营情况
- 3、企业半导体晶圆搬运设备业务布局及发展状况
 - (1) 企业半导体晶圆搬运设备产品类型/型号/品牌
 - (2) 企业半导体晶圆搬运设备业务生产端布局状况
 - (3) 企业半导体晶圆搬运设备业务销售及应用领域
- 4、企业半导体晶圆搬运设备业务最新发展动向追踪
- 5、企业半导体晶圆搬运设备业务发展优劣势分析

8.3.6 济南翼菲自动化科技有限公司

- 1、企业发展历程及基本信息
- 2、企业业务架构及经营情况
- 3、企业半导体晶圆搬运设备业务布局及发展状况
 - (1) 企业半导体晶圆搬运设备产品类型/型号/品牌
 - (2) 企业半导体晶圆搬运设备业务生产端布局状况
 - (3) 企业半导体晶圆搬运设备业务销售及应用领域
- 4、企业半导体晶圆搬运设备业务最新发展动向追踪
- 5、企业半导体晶圆搬运设备业务发展优劣势分析

8.3.7 东莞市智赢智能装备有限公司

- 1、企业发展历程及基本信息
- 2、企业业务架构及经营情况

- 3、企业半导体晶圆搬运设备业务布局及发展状况
 - (1) 企业半导体晶圆搬运设备产品类型/型号/品牌
 - (2) 企业半导体晶圆搬运设备业务生产端布局状况
 - (3) 企业半导体晶圆搬运设备业务销售及应用领域
- 4、企业半导体晶圆搬运设备业务最新发展动向追踪
- 5、企业半导体晶圆搬运设备业务发展优劣势分析

8.3.8 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

- 1、企业发展历程及基本信息
- 2、企业业务架构及经营情况
- 3、企业半导体晶圆搬运设备业务布局及发展状况
 - (1) 企业半导体晶圆搬运设备产品类型/型号/品牌
 - (2) 企业半导体晶圆搬运设备业务生产端布局状况
 - (3) 企业半导体晶圆搬运设备业务销售及应用领域
- 4、企业半导体晶圆搬运设备业务最新发展动向追踪
- 5、企业半导体晶圆搬运设备业务发展优劣势分析

8.3.9 深圳优艾智合机器人科技有限公司

- 1、企业发展历程及基本信息
- 2、企业业务架构及经营情况
- 3、企业半导体晶圆搬运设备业务布局及发展状况
 - (1) 企业半导体晶圆搬运设备产品类型/型号/品牌
 - (2) 企业半导体晶圆搬运设备业务生产端布局状况
 - (3) 企业半导体晶圆搬运设备业务销售及应用领域
- 4、企业半导体晶圆搬运设备业务最新发展动向追踪
- 5、企业半导体晶圆搬运设备业务发展优劣势分析

8.3.10 上海仙工智能科技有限公司

- 1、企业发展历程及基本信息
- 2、企业业务架构及经营情况
- 3、企业半导体晶圆搬运设备业务布局及发展状况
 - (1) 企业半导体晶圆搬运设备产品类型/型号/品牌
 - (2) 企业半导体晶圆搬运设备业务生产端布局状况
 - (3) 企业半导体晶圆搬运设备业务销售及应用领域
- 4、企业半导体晶圆搬运设备业务最新发展动向追踪

5、企业半导体晶圆搬运设备业务发展优劣势分析

第9章：中国半导体晶圆搬运设备行业发展环境洞察

9.1 中国半导体晶圆搬运设备行业经济（Economy）环境分析

9.1.1 中国宏观经济发展现状

9.1.2 中国宏观经济发展展望

9.1.3 中国半导体晶圆搬运设备行业发展与宏观经济相关性分析

9.2 中国半导体晶圆搬运设备行业社会（Society）环境分析

9.2.1 中国半导体晶圆搬运设备行业社会环境分析

9.2.2 社会环境对半导体晶圆搬运设备行业发展的影响总结

9.3 中国半导体晶圆搬运设备行业政策（Policy）环境分析

9.3.1 国家层面半导体晶圆搬运设备行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）

1、国家层面半导体晶圆搬运设备行业政策汇总及解读

2、国家层面半导体晶圆搬运设备行业规划汇总及解读

9.3.2 31省市半导体晶圆搬运设备行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）

1、31省市半导体晶圆搬运设备行业政策规划汇总

2、31省市半导体晶圆搬运设备行业发展目标解读

9.3.3 国家重点规划/政策对半导体晶圆搬运设备行业发展的影响

1、国家“十四五”规划对半导体晶圆搬运设备行业发展的影响

2、“碳达峰、碳中和”战略对半导体晶圆搬运设备行业发展的影响

9.3.4 政策环境对半导体晶圆搬运设备行业发展的影响总结

9.4 中国半导体晶圆搬运设备行业SWOT分析（优势/劣势/机会/威胁）

第10章：中国半导体晶圆搬运设备行业市场前景预测及发展趋势预判

10.1 中国半导体晶圆搬运设备行业发展潜力评估

10.2 中国半导体晶圆搬运设备行业未来关键增长点分析

10.3 中国半导体晶圆搬运设备行业发展前景预测（未来5年数据预测）

10.4 中国半导体晶圆搬运设备行业发展趋势预判（疫情影响等）

第11章：中国半导体晶圆搬运设备行业投资战略规划策略及建议

11.1 中国半导体晶圆搬运设备行业进入与退出壁垒

11.1.1 半导体晶圆搬运设备行业进入壁垒分析

- 11.1.2 半导体晶圆搬运设备行业退出壁垒分析
- 11.2 中国半导体晶圆搬运设备行业投资风险预警
- 11.3 中国半导体晶圆搬运设备行业投资机会分析
 - 11.3.1 半导体晶圆搬运设备行业产业链薄弱环节投资机会
 - 11.3.2 半导体晶圆搬运设备行业细分领域投资机会
 - 11.3.3 半导体晶圆搬运设备行业区域市场投资机会
 - 11.3.4 半导体晶圆搬运设备产业空白点投资机会
- 11.4 中国半导体晶圆搬运设备行业投资价值评估
- 11.5 中国半导体晶圆搬运设备行业投资策略与建议
- 11.6 中国半导体晶圆搬运设备行业可持续发展建议

图表目录

- 图表1：半导体芯片制作前道工艺和后道工艺简介
- 图表2：半导体芯片制作分工示意图
- 图表3：中国半导体晶圆制作工艺及流程
- 图表4：半导体设备类型
- 图表5：《国民经济行业分类与代码》中半导体设备行业归属
- 图表6：半导体搬运设备重要性
- 图表7：半导体晶圆搬运设备的界定
- 图表8：半导体自动物料搬运系统布局情况
- 图表9：半导体晶圆搬运设备专业术语说明
- 图表10：本报告研究范围界定
- 图表11：中国半导体晶圆搬运设备行业监管体系
- 图表12：中国半导体晶圆搬运设备行业主管部门
- 图表13：中国半导体晶圆搬运设备行业自律组织
- 图表14：中国半导体晶圆搬运设备标准体系建设
- 图表15：中国半导体晶圆搬运设备现行标准汇总
- 图表16：中国半导体晶圆搬运设备即将实施标准
- 图表17：中国半导体晶圆搬运设备重点标准解读
- 图表18：本报告权威数据资料来源汇总
- 图表19：本报告的主要研究方法及统计标准说明
- 图表20：全球半导体晶圆搬运设备行业发展历程

图表21：全球半导体晶圆搬运设备企业兼并重组状况

图表22：全球半导体晶圆搬运设备行业市场竞争格局

图表23：全球半导体晶圆搬运设备行业兼并重组状况

图表24：全球半导体晶圆搬运设备行业市场竞争格局

图表25：全球半导体晶圆搬运设备行业市场供需状况

图表26：全球半导体晶圆搬运设备行业市场贸易状况

图表27：2022年全球半导体晶圆搬运设备相关细分领域投资支出结构（单位：亿美元，%）

图表28：2013-2022年全球半导体行业销售额预测（单位：亿美元，%）

图表29：2020-2022年全球半导体及晶圆厂设备规模（单位：亿美元）

图表30：2020-2021年全球半导体晶圆搬运设备市场规模（单位：亿美元）

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0601/202308/25-552116.html>